

1

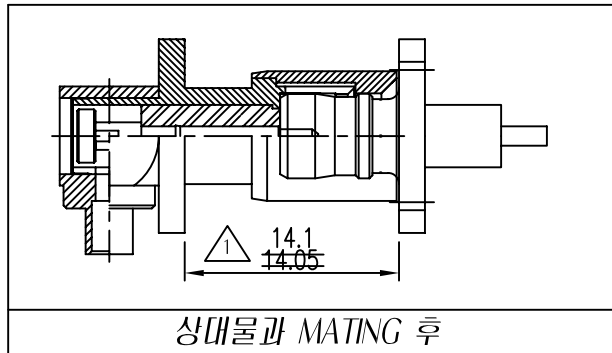
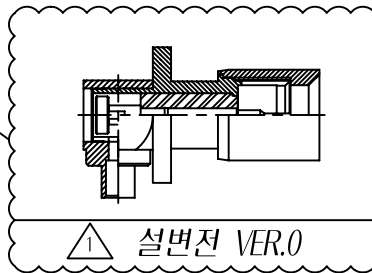
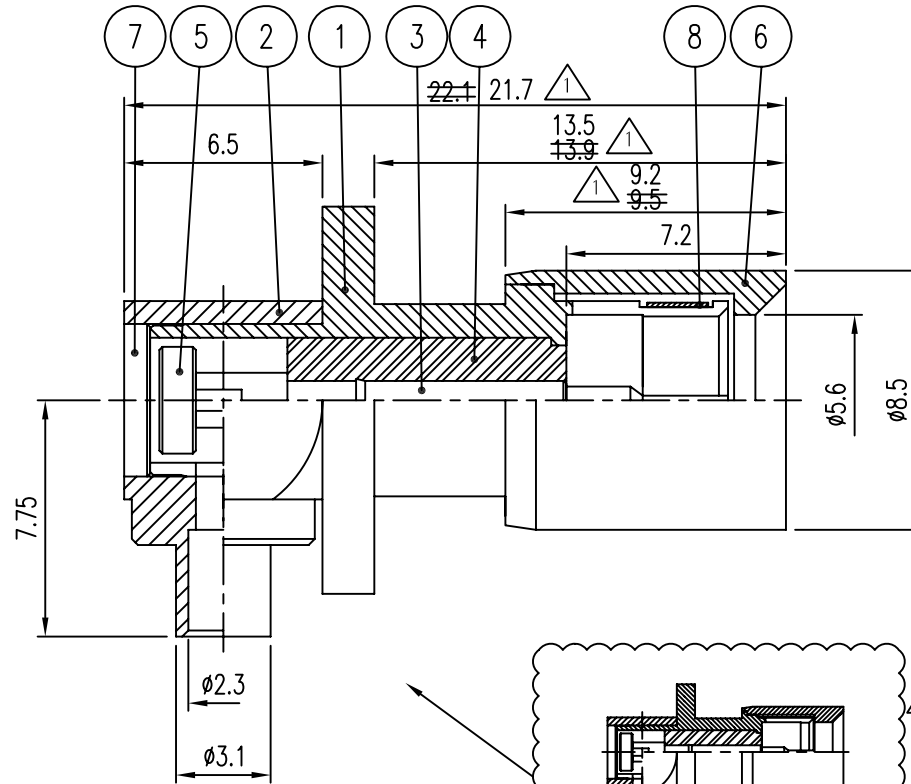
2

3

4

주 기

△△△ 1. 조립 시 작업자가 RING을 커팅 후 사용 할 것.(도면 참조)

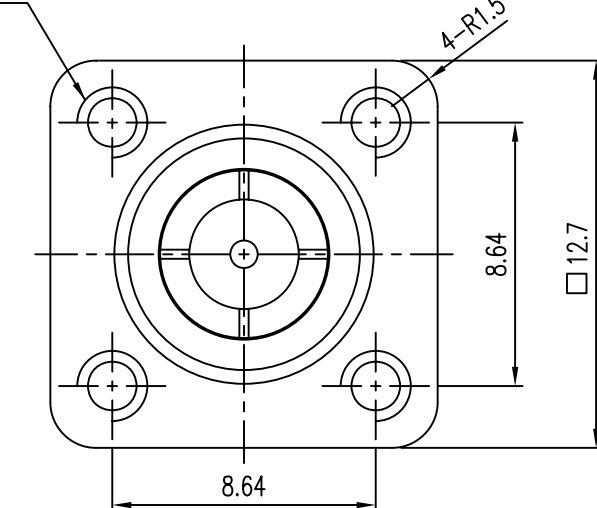


상대물과 MATING 후

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	업체요구 (설변No.연구2006-017) (MATINGAT 유격 개선 구조변경 및 RING 추가 치수변경.)	김인철	최종락	2006. 1. 23.
2	기타(설변No.연구2006-205) (추가 기입)	김은희	윤상진	2006. 10. 18.
3	(설변No.201810-0003) 원기절감 및 배이팅 개선으로 인한 링 삭제	은선영	김인철	2018. 10. 10.
4	(설변No.202006-0005) 배이팅 표준화로 인한 링 재추가	은선영	김인철	2020. 06. 16.

4-M2.3 TAP



8	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00007-5/1 (R2004)
7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00029-5/1 (L3016)
6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00018-5/1 (K2024)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00923-N/1 (H3144)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00230-N/1 (H2323)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00296-5/1 (E2486)
2	BODY(B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00402-3/1 (D2461B)
1	BODY(A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00404-3/1 (D2461A)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질

공통공차

소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일

2005. 12. 8.

승인

검도

제도

작성부서

연 구 소

적도 4/1

단위 mm

중량

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명

SMA-LPS-085 VER.4

A4

도번

CN01729-7/1

K314-637-000